

先端半導体の国内生産円滑化のための利子補給金

令和4年度予算額 0.9億円（新規）

事業の内容

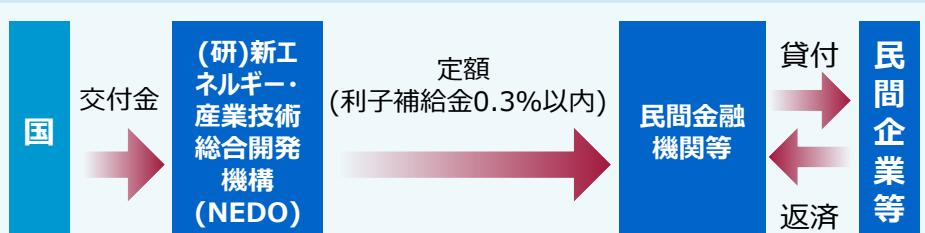
事業目的・概要

- 半導体は、デジタル化の進展により、自動車や医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情から、グローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっています。あらゆる産業に影響を与え、5Gシステムに不可欠な先端半導体の安定供給を確保することが、産業基盤の強靭化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、最重要課題となっています。
- 本事業では、先端半導体の国内生産拠点を整備するとともに、その拠点での継続生産や、参画企業との共同研究開発等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給を実現します。具体的には、5G促進法（※）に基づいて認定を受けた先端半導体の生産施設整備及び生産に関する計画について、認定を受けた事業者が計画の実施に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し、利子補給金を支給します。

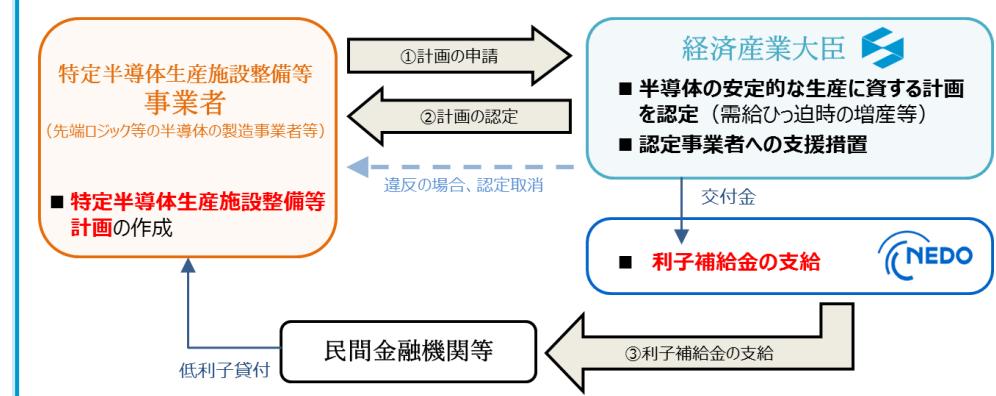
成果目標

- 産業基盤の強靭化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、不可欠な先端半導体について、国内の生産拠点整備への支援を行うことで、事業者による投資判断を後押しし、安定供給の確保を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）



事業イメージ



特定半導体生産拠点整備等計画の認定（補助）

【支援対象】

特定半導体について、生産施設の整備及び生産を行う計画

【認定基準】

- ・指針への適合性、事業実施の確実性
- ・一定期間以上継続的な生産
- ・国内での安定的な生産に資する取組を行うもの
(需給ひっ迫時の増産、生産能力強化のための投資及び研究開発等)
- ・技術上の情報管理のための体制整備